

2021-2026年中国高性能集成电路行业市场调研及 行业投资策略研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国高性能集成电路行业市场调研及行业投资策略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/ic/660792.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 高性能集成电路的行业界定

第一节 高性能集成电路的定义

第二节 高性能集成电路的行业发展历程

第三节 高性能集成电路的分类

第四节 高性能集成电路的特

第五节 高性能集成电路发展的重要意义

第二章 2016-2020年中国高性能集成电路行业发展环境分析

第一节 2016-2020年中国经济环境分析

一、宏观经济

二、工业形势

三、消费价格指数分析

四、城乡居民收入分析

五、全社会固定资产投资和工业投资分析

六、进出口总额及增长率分析

第二节 2016-2020年中国高性能集成电路的行业发展政策环境分析

一、行业发展相关政策

颁布时间

二、行业政策影响分析

三、相关行业标准分析

第三节 2016-2020年中国高性能集成电路的行业发展技术环境分析

一、技术发展概况

二、技术发展趋势分析

第四节 "十四五"规划相关解读

第三章 2020年中国高性能集成电路发展现状分析

第一节 我国高性能集成电路行业发展现状

一、国际技术和市场形势分析

二、中国本土企业的借鉴经验

三、高性能集成电路产业继续突围发展的基本要领

第二节 高性能集成电路业：发展模式转型内需拉动回升

- 一、扩内需使行业企稳回升
- 二、产业链上下游重组初现
- 三、高投入和高产出
- 四、国际化发展模式
- 五、周期性运行

第三节 中国高性能集成电路行业发展趋势分析

- 一、未来中国高性能集成电路设计产业发展方向
- 二、高性能集成电路封装技术的发展趋势

第四章 2020年中国高性能集成电路行业发展分析

第一节 2020年中国高性能集成电路的行业发展态势分析

第二节 2020年中国高性能集成电路的行业发展特点分析

第三节 2020年中国集成电路市场规模分析

第四节 2020年中国高性能集成电路的行业市场供需分析

- 一、我国高性能集成电路行业的快速发展与市场供给不足的矛盾依然持续
- 二、未来需求增长国内集成电路加大产能
- 三、供需趋势预测分析

第五章 我国高性能集成电路行业国家发展规划及产业政策

第一节 高性能集成电路产业发展规划

- 一、产业规划的目标
- 二、《规划》实施的重点内容
- 三、《规划》面临的形势

第二节 国家资源综合利用产业政策分析

第三节 国家对高性能集成电路产业的政策

第四节 我国规划将实施的高性能集成电路措施及政策

- 一、落实扩大内需措施
- 二、加大国家投入
- 三、加强策扶持
- 四、完善投融资环境
- 五、支持优势企业并购重组
- 六、进一步开拓国际市场
- 七、强化自主创新能力建设

第六章 高性能集成电路行业技术分析

第一节 中国高性能集成电路行业技术发展现状

- 一、高性能集成电路工艺发展现状

二、高性能集成电路技术现状

三、高性能集成电路行业技术的更新

四、技术水平快速提高，技术与产品创新取得显著成果

第二节 中国高性能集成电路最新技术动态

一、我国集成电路攻关喜获成绩

二、我集成电路装备研发获重大突破

三、集成电路多项核心技术获突破销售逾百亿

四、“集成电路装备专项”带动相关产业增长近千亿元

五、中国集成电路制造水平首次达到国际先进水平

六、我国集成电路企业努力抢占封测技术高地

七、我国高性能数模混合集成电路设计获突破

八、松下半导体公司开发出世界最小集成电路芯片

第三节 中国高性能集成电路技术建议及策略

一、突破集成电路等核心产业的关键技术

二、技术提升助力发展模式转型

第七章 中国高性能集成电路行业重点企业运营财务数据分析

第一节 同方股份有限公司

一、企业概况

二、企业财务情况分析

三、企业主营业务分析

第二节 江苏综艺股份有限公司

一、企业概况

二、企业财务情况分析

三、企业主营业务分析

第三节 上海贝岭股份有限公司

一、企业概况

二、企业财务情况分析

三、企业主营业务分析

第四节 贵州三佳科技有限公司

一、企业概况

二、企业财务情况分析

三、企业主营业务分析

第五节 通富微电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业财务情况分析

三、企业主营业务分析

第六节 天水华天科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业财务情况分析

三、企业主营业务分析

第七节 江苏长电科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业财务情况分析

三、企业主营业务分析

第八章 高性能集成电路行业市场竞争策略分析

第一节 行业竞争结构分析

一、行业产品竞争结构

二、行业企业竞争格局

三、行业应用领域竞争格局

第二节 高性能集成电路的市场竞争策略分析

一、高性能集成电路的市场增长潜力分析

二、IP核是我国集成电路设计产业发展重中之重

三、中国芯片企业猛生芯片企业数量和质量齐升

第三节 高性能集成电路的企业竞争策略分析

第九章 高性能集成电路行业投资分析

第一节 2020年高性能集成电路行业投资情况分析

一、中国未来五年将向集成电路行业投资250亿美元

二、2020年集成电路及相关行业固定资产投资情况

三、高性能集成电路行业重点投资方向

四、高性能集成电路行业投资新方向

第二节 高性能集成电路的投资项目分析

第三节 2020年高性能集成电路的投资机会分析

第十章 高性能集成电路产业链分析

第一节 高性能集成电路行业产业链概况

第二节 高性能集成电路上下游行业分析

一、上游行业垄断程度高

二、下游行业分析

第三节 主要原材料供应及价格分析

一、高性能集成电路原材料概况

二、中国多晶硅供求市场分析

三、日本地震意外拉动多晶硅市场价格上涨

四、国内高性能集成电路加大产能上下游芯片需求强劲

第十一章 2021-2026年中国高性能集成电路行业发展前景预测分析

第一节 高性能集成电路产业发展10年回顾分析

一、产业规模不断扩大，三业比重渐趋合理

二、技术水平不断提高，知识产权取得突破

三、优势企业不断涌现，产业链互动日趋活跃

四、海内外人才大量汇聚，产业与资本良性互动

五、公共服务成效显著，产业环境日趋完善

第二节 高性能集成电路的行业发展前景分析

一、贸易战下高性能集成电路的市场的市场前景

二、2020年高性能集成电路的市场面临的发展商机

三、“十四五”高性能集成电路产业的发展机遇

第三节 高性能集成电路未来发展预测分析

一、中国高性能集成电路的行业发展规模预测

二、2021-2026年中国高性能集成电路的行业发展趋势预测

第十二章 2021-2026年高性能集成电路行业投资风险分析

第一节 当前高性能集成电路的存在的问题（AK ZJH）

第二节 2021-2026年中国高性能集成电路的行业投资风险分析

一、市场竞争风险

二、原材料压力风险分析

三、技术风险分析

四、政策和体制风险

五、投融资风险

六、外资进入现状及对未来市场的威胁

七、进入退出风险

八、信贷建议

第三节 行业建议

图表目录：

图表1：2020年主要统计数据

图表2：中国高性能集成电路行业主要政策措施一览表

图表3：2016-2020年中国集成电路市场销售额规模及增长率

图表4：新老十八号文主要政策对比表

图表5：全球运用纳米技术的集成电路市场预测

图表6：集成电路的技术发展趋势图

图表7：同方股份概况

图表8：2016-2020年同方股份主要财务指标分析

图表9：2016-2020年同方股份资产与负债表分析

图表10：2016-2020年同方股份利润构成与盈利能力分析

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/ic/660792.html>